

MES 2017 プログラム			8月29日(火)		
	A会場	B会場	C会場	D会場	E会場
9:50	<b>[1A1] パワーエレクトロニクス-1</b> 座長：山田靖 (大同大学) 1. パワー半導体応用における誤点弧メカニズム解析 ○山本真義(名古屋大学) (依頼講演40分) 2. 多孔質焼結銀接合材の疲労き裂進展解析技術の開発 ○鈴木智久 <sup>1</sup> , 寺崎健 <sup>1</sup> , 保田雄亮 <sup>1</sup> , 守田俊章 <sup>1</sup> , 川名祐貴 <sup>2</sup> , 石川大 <sup>2</sup> , 西村正人 <sup>2</sup> , 中子俣夫 <sup>2</sup> , 蔵潤和彦 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 日立製作所, <sup>2</sup> 日立化成) 3. ラマン分光法によるモールド樹脂に起因する半導体パッケージの応力評価 ○内田智之, 杉江隆一, 伊藤元剛(東レリサーチセンター) 4. はんだ接合部エレクトロマイグレーション故障時間を与えるSn結晶方位の定量化 ○渡邊英之 <sup>1</sup> , 酒井翼 <sup>1</sup> , 瀬井翼 <sup>1</sup> , 野口真実 <sup>2</sup> , 山中公博 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 中京大学, <sup>2</sup> トヨタ自動車) 5. 高温実装用ニッケルナノ粒子接合材料の信頼性評価 ○千葉将之 <sup>1</sup> , 宇野智裕 <sup>1</sup> , 松原典恵 <sup>2</sup> , 清水隆之 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 新日鐵住金, <sup>2</sup> 新日鐵住金化学)	<b>[1B1] 新規接合材料</b> 座長：西川宏 (大阪大学) 1. 酸化銅-酸化銀混合ペースト接合を用いた銅継手の接合性評価 ○八尾崇史, 松田朋己, 佐野智一, 廣瀬明夫(大阪大学) 2. パワーモジュールのチップ下接合層における鉛直方向破壊と熱抵抗との相関調査 ○福本晃久, 田中陽, 横山吉典(三菱電機) 3. Sn薄膜を用いたCuの固液反応拡散接合における初期欠陥形成 ○福本信次 <sup>1</sup> , 木澤利成 <sup>1</sup> , 松嶋道也 <sup>1</sup> , 外園洋昭 <sup>2</sup> , 藤本公三 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 大阪大学, <sup>2</sup> 富士電機) 4. 樹脂-金属界面の応力成分と接着強度 ○松嶋道也, 藤井達哉, 福本信次, 藤本公三(大阪大学) 5. Agミクロ粒子の低温焼結誘導可能なメルカプトカルボン酸類の分子構造上の特徴 ○井上雅博, 中澤志徳(群馬大学) 6. トランスファーモールド構造のモジュールへのAgワイヤ適用 ○作谷和彦, 佐藤正章, 近藤聡, 鹿野武敏, 山崎浩次(三菱電機)	<b>[1C1] プリントエレクトロニクス-1</b> 座長：大塚邦顕 (奥野製薬工業) 1. エッチング工程不要の環境配慮型プリント配線基板製造工法の開発 ○加藤義尚(福岡大学) (依頼講演40分) 2. 印刷法で作製した金属-半導体間の電氣的接合評価法の開発: Agナノインクを用いたSiウエハへの評価用電極パターン形成 ○齊藤大志, 柏木行康, 千金正也(大阪産業技術研究所) 3. 全方向インクジェット(OIJ)技術による樹脂製立体物表面への印刷配線形成 ○吉田泰則, 和田輝, 泉小波, 時任静士(山形大学) 4. 受理解特性に優れたソフトブランケットグラビア印刷技術II ○泉小波, 和田輝, 吉田泰則, 時任静士(山形大学) 5. 印刷有機デバイス用ポリパラキシレンの引張特性 ○笹川宗太郎 <sup>1</sup> , 矢野信之 <sup>2</sup> , 小倉正明 <sup>1</sup> , 関根智仁 <sup>1</sup> , 池田徹 <sup>1</sup> , 神谷庄司 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 鹿児島大学, <sup>2</sup> 北九州市環境エレクトロニクス研究所, <sup>3</sup> 山形大学, <sup>4</sup> 名古屋工業大学)	<b>[1D1] ものづくりセッション-1</b> 座長：山田聡 (三菱電機) 1. 電子機器実装用低温・短時間硬化接着剤 ○徳平英士, 北村和夫, 八木友久, 伊達仁昭(富士通クオリティラボ) 2. 低温焼結能を有する銀ナノ粒子の開発と実装用途への応用 ○三並淳一郎, 森崇充, 岩佐成人, 福井太郎(大阪ソーダ) 3. FO-WLPにおけるコンプレッションモールド成形技術 ○高橋範行(TOWA) 4. FOWLP/FOPLPに内蔵する部品装着技術 ○楠一弘(富士機械製造) 5. レーザーを応用したTGV技術 - LPKF LIDE ○上館寛之(LPKF Laser&Electronics)	<b>[1E1] 最先端材料-1</b> 座長：油谷義樹 (村田製作所) 1. 低温硬化可能な新規高伸度ポジ型感光性ポリイミドの開発 ○橋本啓華, 増田有希, 荒木齊, 荻可優, 小山祐太郎, 磯部王郎, 西村拓真, 奥田良治(東レ) 2. 低温硬化ポジ型感光性樹脂の高溶解コントラスト化 ○四柳樹子, 中村惟允, 松川大作, 山崎龍幸, 元部丈晴(日立化成デュボンマイクロシステムズ) 3. 電析法を用いた硫化鉄の製と光電気化学反応機構の考察 ○岡本尚樹, 湯川光, 齊藤丈晴(大阪府立大学) 4. 銀ナノ粒子めっき触媒を用いた配線板のエレクトロケミカルマイグレーション評価 ○富士川巨, 深澤憲正, 白髪潤(DIC) 5. 板成形したエポキシ変性ベンゾオキサジン樹脂の異質性 ○柳浦聡 <sup>1</sup> , 高橋昭雄 <sup>2</sup> , 大山俊幸 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 三菱電機, <sup>2</sup> 横浜国立大学) 6. 硫酸に酸化チタン粉末を加えた電解液で陽極酸化したチタン板の牛血清アルブミンの吸着能 ○加藤佑弥 <sup>1</sup> , 片山真久寿 <sup>1</sup> , 蟹江祐輔 <sup>2</sup> , 野浪亨 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 中京大学, <sup>2</sup> 元中京大学)
11:50				(~11:30)	
12:40	<b>[1A2] パワーエレクトロニクス-2</b> 座長：長尾至成 (大阪大学) 1. プリント基板を活用したパワーエレクトロニクス機器における熱伝導冷却技術の開発 ○藤井健太, 佐藤翔太, 白形雄二, 中島浩二, 熊谷隆, 大川太(三菱電機) 2. 高放熱材料を用いたパワーモジュールのパワーサイクル寿命 ○指田和之, 竹原奈津紀(新電元工業) 3. 高放熱基板用耐熱樹脂の開発 ○水野克美, 池田大記, 奥野彰史, 木内陽子(日本電産) 4. パワーモジュール用高耐熱封止樹脂のはく離強度評価 ○井上航太郎 <sup>1</sup> , 池田徹 <sup>1</sup> , 小倉正明 <sup>1</sup> , 中井戸宙 <sup>2</sup> , 畑尾卓也 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 鹿児島大学, <sup>2</sup> 住友ベークライト) 5. 耐熱性と接着性を有するエポキシ樹脂の設計 ○村上泰 <sup>1</sup> , 小林正美 <sup>1</sup> , 仲俣祐子 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 信州大学, <sup>2</sup> 富士電機)	<b>[1B2] カーエレクトロニクス</b> 座長：西村芳孝 (富士電機) 1. 車載半導体の動向と実装技術の行方 ○植田展正(デンソー) (依頼講演40分) 2. 無加圧窒素雰囲気による銅ナノ粒子接合の特性評価 ○長谷川和基 <sup>1</sup> , 粕谷雅人 <sup>1</sup> , 金子俊輔 <sup>1</sup> , 植村優夫 <sup>1</sup> , 山田靖 <sup>2</sup> , 長田裕仁 <sup>2</sup> , 佐野義之 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 大同大学, <sup>2</sup> DIC) 3. 高Pb含有はんだ/Cuフレーム界面における金属間化合物形成とその抑制 ○前川拓澄 <sup>1</sup> , 金吹珠 <sup>2</sup> , 眞砂紀之 <sup>1</sup> , 西川宏 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> ローム, <sup>2</sup> 大阪大学) 4. IC/LSIのEMC解析に向けた伝導性エミッション/イミュニティマイクロモデル構築検討 ○宮原秀敏, 今泉祐介, 岡野資隆(東芝デバイス&ストレージ)	<b>[1C2] プリントエレクトロニクス-2</b> 座長：柏木行康 (大阪産業技術研究所) 1. 印刷配線を用いた電池交換不要な小型薄型ピーコンの開発 ○中本裕之(富士通研究所) (依頼講演40分) 2. 銅ナノインクと電気めっきを用いたフレキシブル基板上での回路形成と焼成銅皮膜と基材の密着機構 ○三田倫広, 南原聡, 有村英俊(石原ケミカル) 3. 初期抵抗値が低く伸張時の抵抗値上昇を抑えた印刷可能な導電性ペーストの開発 ○坂本孝史, 荻原敏明(ナミックス) 4. 親水撥水表面パターンを用いた銀ナノワイヤ透明電極の微細形成 ○竹本明寿也, 荒木徹平, 野田祐樹, 吉本秀輔, 植村隆文, 関谷毅(大阪大学)	<b>[1D2] ものづくりセッション-2</b> 座長：山口敦史 (パナソニック) 1. プリント基板製造プロセスで創出する熱電変換機能デバイス内蔵 熱流センサー[IRAFESPA] ○多田和夫, 清水元規, 青山雅之(デンソー) 2. 3次元電気系CAD[CR-8000 Design Force]によるMID, FO-WLPなど次世代実装技術への取組み ○長谷川清久 <sup>1</sup> , 松澤浩彦 <sup>1</sup> , 福岡伸 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 図研, <sup>2</sup> 図研テック) 3. ナノフォースとハイパワーを両立したマルチフォースX線によるX線検査・解析事例 ○清宮直樹 <sup>1</sup> , 岡本慎太郎 <sup>1</sup> , 川田真也 <sup>1</sup> , 松下大作 <sup>1</sup> , Rene Sommer <sup>2</sup> , Friedhelm Maur <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> エクシロン・インターナショナル, <sup>2</sup> YXLON International GmbH) 4. 車載機器の水はねによる耐性を評価するスプラッシュウオーター試験装置の開発 ○榎浩之, 田中秀樹, 梁井誠(エスベック)	<b>[1E2] 最先端材料-2</b> 座長：折井靖光 (長瀬産業) 1. はんだ付け性および機械的特性に対するわずかの微量元素の影響 ○岩田典也, 山下清敏, 北川惣康, 出田吾朗, 大川太(三菱電機) 2. Sn-Ag-Bi-In-Cu系はんだの接合信頼性に及ぼす熱サイクル負荷とSb添加の影響 ○三原一樹 <sup>1</sup> , 日根清裕 <sup>2</sup> , 乗塚笠法 <sup>2</sup> , 酒谷茂昭 <sup>2</sup> , 秋山真之介 <sup>2</sup> , 上西啓介 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 大阪大学, <sup>2</sup> パナソニック) 3. 導電性接着剤中のAgフレークのネットワーク構造形成と導電バス発達 ○根岸智仁, 井上雅博(群馬大学) 4. 軽量スマート構造材料のための有機無機ハイブリッド接合 ○重藤暁洋 <sup>1</sup> , 楊弘偉 <sup>1,2</sup> , 付偉近 <sup>2</sup> , 水野潤 <sup>3</sup> , 高振宏 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 物質・材料研究機構, <sup>2</sup> 国立台湾大学, <sup>3</sup> 早稲田大学)
14:20				(~14:00)	(~14:00)
14:00	ものづくりコアタイム				
15:00					

1号館 3階 清明ホール	
15:10	MES2016表彰式
15:30	招待講演
16:30	1. 環境対応車向けパワーモジュールの実装技術 門口卓矢氏(トヨタ自動車)
16:30	招待講演
17:30	2. 網膜モデルに基づく画像予測器を用いたスケーラブル画像符号化 青森久氏(中京大学)
17:50	交流会
19:50	会場: 2号館 アレーナ211

**A会場: 1号館 3階 清明ホール**  
**B会場: 1号館 3階 132**  
**C会場: 1号館 3階 133**  
**D会場: 1号館 5階 151**  
**E会場: 1号館 5階 154**  
**ものづくり展示コーナー: 1号館 5階 ラウンジ**  
**受付: 1号館 3階 ラウンジ**

MES 2017 プログラム		8月30日(水)			
	A会場	B会場	C会場	D会場	E会場
9:00	<p><b>[2A1] ミッションフェロセッション</b> 座長：畠山友行 (富山県立大学)</p> <p><b>AIは敵か味方か?</b></p> <p>1. コグニティブ・コンピューティングに向けたHW技術 <b>★講演変更</b> ○細川浩二 (日本アイ・ピー・エム) (9:15~9:55)</p> <p>2. 知能化モビリティ: ホンダの取組と将来 ○坂上義秋 (本田技術研究所) (9:55~10:35)</p> <p>3. ヒューマノイドからガンダムまで ○橋本周司 (早稲田大学) (10:40~11:20)</p>	<p><b>[2B1] 信頼性・評価・解析技術-1</b> 座長：江森雄二 (沖エンジニアリング)</p> <p>1. エレクトロケミカルマイグレーション (ECM) による劣化現象を通して考える信頼性評価の在り方 ○津久井勲 (リサーチラボ・ツクイ) (依頼講演40分)</p> <p>2. レーザはんだ付部の衝撃強度に対するNi微量添加の影響 ○松延涼, 西川宏 (大阪大学)</p> <p>3. エレクトロマイグレーションによるはんだ接続部の断線現象 第二報 ○田辺一彦, 戸島寛, 高橋政典 (クオルテック)</p>	<p><b>[2C1] アディティブマニュファクチャリング・立体回路基板</b> 座長：井上雅博 (群馬大学)</p> <p>1. 特殊ブレンド機構を用いたフレキシブルディスプレイ用筐体の開発 ○中村裕 (富士通研究所)</p> <p>2. 高速・高精細金属3Dプリンタの開発 ○堀見康友<sup>1</sup>, 大野博司<sup>2</sup>, 藤巻晋平<sup>3</sup>, 岡田直忠<sup>1</sup> (東芝, <sup>2</sup>東芝機械)</p> <p>3. 銅ペーストによる配線形成技術 ○浦島航介, 納堂高明, 米倉元気, 明比龍史, 谷中勇一, 江尻芳則 (日立化成)</p> <p>4. LDS (Laser Direct Structuring) を用いたMID (Molded Interconnect Device) に適した無電解銅めっき ○本間秀和, 委俊行 (興野製業工業)</p>	<p><b>[2D1] 高速高周波・電磁特性技術</b> 座長：森裕幸 (日本アイ・ピー・エム)</p> <p>1. 極低温下におけるInAlAs/InGaAs系HEMTの真性遅延時間の解析 ○栗本凱斗, 中野風也, 大嶽晃慶, 山中公博, 田口博久 (中京大学)</p> <p>2. ICTS/DLTS法によるGaN系HEMTの電流コラプス現象の温度依存性 ○赤堀一登, 大嶽晃慶, 中野風也, 久瀬直矢, 山中公博, 田口博久 (中京大学)</p> <p>3. 折り曲げたUWB用半円台形不平衡ダイポールアンテナにおけるスリット装荷による2.4GHz帯無線LANへの対応 ○島崎勇登<sup>1</sup>, 越地福朗<sup>2</sup>, 越地耕二<sup>2</sup> (東京工芸大学, <sup>2</sup>東京理科大学)</p> <p>4. SAPとタマシ工による微細CPW伝送線路の高周波伝送特性評価 ○小川剛司, 韓榮建, 崔雲, 鈴木孝将 (福岡大学)</p>	<p><b>[2E1] 表面処理・めっき技術-1</b> 座長：大塚邦顕 (興野製業工業)</p> <p>1. 高速伝送基板向け平滑銅表面密着向上技術 ○吉海雅史 (メック) (依頼講演40分)</p> <p>2. 無電解Ni/Pd/AuめっきにおけるCuワイヤ接続信頼性・ボンディングパラメータの影響 ○江尻芳則, 櫻井健久<sup>1</sup>, 荒山貴慎<sup>2</sup>, 坪松良明<sup>3</sup>, 長谷川清<sup>1</sup> (日立化成, <sup>2</sup>日立化成テクノサービス)</p> <p>3. ENIEPIGめっき皮膜のエレクトロマイグレーション評価 ○柴山文徳, 笹村哲也, 古矢絵理子, 前田剛志, 田邊克久, 小田幸典, 橋本滋雄 (上村工業)</p>
10:20	<p>4. パネルディスカッション 「ロボット・AI・自動運転… 未来技術について語り合おう!」 (11:20~12:10)</p>	<p><b>[2B2] 信頼性・評価・解析技術-2</b> 座長：齊藤雅之 (東芝)</p> <p>1. 低融点はんだBGA接合部のき裂発生および進展予測シミュレーションの精度検証 ○福岡健治, 小出正輝, 渡邊真名武 (富士通アドバンステクノロジー)</p> <p>2. BGAパッケージのCuワイヤボンディング接合部の応力シミュレーション手法の検証 ○野坂圭司, 大島有美子, 須田亨, 平井達也, 梅本昭宏, 河津剛史 (ジェイデバイス)</p> <p>3. 電子パッケージのひずみ計測への位相シフトサンプリングモアレ法の適用 ○小金丸正明<sup>1</sup>, 松本光気<sup>1</sup>, 内野正和<sup>2</sup>, 池田敏<sup>1</sup> (鹿児島大学, <sup>2</sup>福岡県工業技術センター)</p> <p>4. Air-HASTによる加速試験 ○鈴木聡 (エスベック)</p>	<p><b>[2C2] 配線板・インターポーザ</b> 座長：福岡義孝 (ウェイスティアー)</p> <p>1. 熱伝達ノイズキャンセル機能付き熱特性測定装置とTIM-CCL基板 ○森邦夫<sup>1</sup>, 森克仁<sup>1</sup>, 大村慎吾<sup>1</sup>, 別所毅<sup>2</sup>, 名屋茂<sup>3</sup>, 奥村智之<sup>4</sup>, 八甫谷明彦<sup>5</sup> (おおう化学研究所, <sup>2</sup>トヨタ自動車, <sup>3</sup>メイコー, <sup>4</sup>富士高分子工業, <sup>5</sup>東芝)</p> <p>2. 多層有機基板の層厚ばらつきによる反り挙動への影響 ○小原さゆり, 岡本圭司, 森裕幸 (日本アイ・ピー・エム)</p> <p>3. 広帯域信号伝送用Siインターポーザにおける信号特性と配線密度のトレードオフ解析 ○福盛大雅, 赤星知幸, 田代浩子, 水谷大輔 (富士通研究所)</p> <p>4. MSAPによる微細銅回路形成の可能性 ○坂本成美<sup>1</sup>, 渡口繁<sup>2</sup>, 渡邊秀樹<sup>3</sup>, 新井宏忠<sup>1</sup>, 松本克才<sup>1</sup> (八戸工業高等専門学校, <sup>2</sup>メルテックス)</p> <p>5. 薄膜キャパシタ内蔵大規模パッケージ基板の開発 ○渡邊真名武<sup>1</sup>, 小出正輝<sup>2</sup>, 福岡健治<sup>1</sup>, 安達裕幸<sup>3</sup>, 山田暉<sup>4</sup>, 水谷大輔<sup>5</sup>, 赤星知幸<sup>6</sup>, 藤崎彦彦<sup>7</sup>, 山崎清吾<sup>8</sup>, 福井慧<sup>9</sup> (富士通アドバンステクノロジー, <sup>2</sup>富士通, <sup>3</sup>富士通研究所, <sup>4</sup>富士通インターコネクテックソリューションズ)</p>	<p><b>[2D2] 検査・センシング技術-1</b> 座長：平井義和 (京都大学)</p> <p>1. アンモニアを狙い撃ちにする呼吸センサーの開発とストレス検知の検討 ○百瀬信 (富士通研究所) (依頼講演40分)</p> <p>2. 超高感度分子センシングを目指したマイクロ化学チップの検討 ○山口明啓, 福岡隆夫, 内海裕一 (兵庫県立大学)</p> <p>3. IEEE Std.1149.1のBC_1タイプのバウンダリスキャンセルを用いた実装基板のオンライン配線検査法 ○数井大輔, 四柳浩之, 橋爪正樹 (徳島大学)</p> <p>4. 良品解析による高信頼性部品選定手法の研究 ○田中章, 多田志志, 梶根二 (東芝)</p>	<p><b>[2E2] 表面処理・めっき技術-2</b> 座長：藤原裕 (大阪産業技術研究所)</p> <p>1. 新規高耐久性Ag-Sn合金めっきの構造及び特性 ○児玉篤志, 遠藤賢, 相塚玲宏 (JX金属)</p> <p>2. シリコン基板上に形成した無電解めっきバリ合金膜の熱安定性評価 ○井澤秀樹, 宮地悠人, 深堂秀亮, 稲田純也, 清水智弘, 伊藤健, 新宮原正三 (関西大学)</p> <p>3. グラフェンシート上に配置したCuペンドライド構造による熱輻射特性 ○久瀬直矢, 中野風也, 大嶽晃慶, 山中公博, 田口博久 (中京大学)</p> <p>4. 光還元法による樹脂上への金属皮膜形成 ○藤原良輔, 平木秀典, 杉谷優衣, 高嶋洋平, 鶴岡孝章, 赤松謙祐 (甲南大学)</p> <p>5. Naイオン二次電池用Ag-Sn系複合負極の作成と評価 ○清本雅貴, 岡本尚樹, 齊藤大靖 (大阪府立大学)</p>
12:10	<p><b>[2A2] パワーエレクトロニクス-3</b> 座長：石川岳史 (デンソー)</p> <p>1. パワーエレクトロニクス産業の動向とパワーデバイス実装への要求 ○山本秀和 (千葉工業大学) (依頼講演40分)</p> <p>2. Cuナノ粒子/Bi-Sn合金ハイブリッド接合 ○佐藤敏一, 石崎敏孝, 白井正則 (豊田中央研究所)</p> <p>3. 無加圧接合用焼結Cuダイボンド材料の開発 ○川名祐貴, 根岸征央, 石川大, 須鎌千絵, 中子俊夫, 江尻芳則 (日立化成)</p> <p>4. Cu-Mg合金のデアロイニングによるCuナノボラス構造の作製と接合への応用 ○古賀俊一<sup>1</sup>, ミンス キム<sup>1</sup>, 齋藤美紀子<sup>2</sup>, 水野潤<sup>3</sup>, 西川宏<sup>1</sup> (大阪大学, <sup>2</sup>早稲田大学)</p>	<p><b>[2B3] 信頼性・評価・解析技術-3</b> 座長：生野元 (豊田中央研究所)</p> <p>1. 顕微ラマンイメージングによる低温領域の4H-SiC結晶のLOPCモードの温度依存性に関する研究 ○水野修吾, 諏訪智志, 東郷考起, 須田潤 (中京大学)</p> <p>2. 顕微ラマンイメージングによる高温状態の電極付4H-SiC結晶の残留応力分布に関する研究 ○諏訪智志, 東郷考起, 水野修吾, 須田潤 (中京大学)</p> <p>3. 無電解Ni-P/電解Cuめっきが高温環境下のはんだ接合信頼性に及ぼす影響 ○大矢伶史, 中木原早紀, 朴潤烈, 高橋政典, 芳井敏之, 新子比呂志 (クオルテック)</p> <p>4. プラズマロケット搭載衛星における数値解析による太陽電池パネルの損耗評価 ○村中崇信<sup>1</sup>, 福永康隆<sup>2</sup> (中京大学, <sup>2</sup>三菱電機)</p>	<p><b>[2C3] 3次元ICパッケージ-1</b> 座長：岩田剛治 (大阪大学)</p> <p>1. 5G時代に向けてのパッケージトレンド ○西尾俊彦 (SBRテクノロジー) (依頼講演40分)</p> <p>2. 3次元実装のためのシリコンTSV故障評価 ○崔雲, 末次正 (福岡大学)</p> <p>3. ヘテロジニアスWLCSPのための高品質バックサイドビア形成技術 ○村山貴英, 鈴木亮由, 作石敏幸, 森川泰宏 (アルバック)</p>	<p><b>[2D3] 検査・センシング技術-2</b> 座長：齊藤雅之 (東芝)</p> <p>1. interactive shoes hubに向けた小型センサーの開発 ○島内岳明, 勝本隆史, 豊田治 (富士通研究所)</p> <p>2. 傷の気付き特徴を用いたCNN (Convolutional Neural Network) による欠陥検出手法の検討 ○大野光洋, 片山隼多, 吉村裕一郎, 青木公也, 興水大和 (中京大学)</p> <p>3. 画像位置決めのためのDeep Neural Networkの中間層を利用したマッチングパラメータの自動決定 ○藤原伸之, 奥川尚太, 橋本学 (中京大学)</p> <p>4. 床面電極を利用する人体通信における伝送特性と生体安全性 ○藤田佑輔<sup>1</sup>, 越地福朗<sup>2</sup>, 越地耕二<sup>2</sup> (東京工芸大学, <sup>2</sup>東京理科大学)</p>	<p><b>[2E3] JEITA・実装技術ロードマップ2017報告会-1</b> (13:00-15:00) 座長：本多進 (C-NET)</p> <p>1. はじめに(ロードマップの経緯と概要紹介) ○小池純 (村田製作所)</p> <p>2. 注目される市場と電子機器群 1) 全体概要とメディカル・エネルギーの概要 ○深澤秀幸 (日立製作所) 2) Mobility ○松本弘 (京セラ) 3) 新技術・新材料・新市場 ○森村人 (パナソニック)</p> <p>3. IoT、トリリオンセンサに向けた小型、低コスト半導体パッケージ技術 ○尾崎裕司 (ソニーセミコンダクタソリューションズ)</p>
14:40					
14:20	ものづくりコアタイム				
15:10	<p><b>[2A3] パワーエレクトロニクス-4</b> 座長：出田吾朗 (三菱電機)</p> <p>1. Ag焼結接合材料の熱安定性の向上 ○杉浦和彦<sup>1</sup>, 岩重朝仁<sup>1</sup>, 河合潤<sup>1</sup>, 鶴田和弘<sup>1</sup>, 陳俊トウ<sup>2</sup>, 長尾至成<sup>2</sup>, 張昊<sup>3</sup>, 菅原徹<sup>4</sup>, 菅沼克昭<sup>5</sup> (デンソー, <sup>2</sup>大阪大学)</p> <p>2. 銀焼結接合ダイアタッチ技術の薄チップデバイスへの応用評価 ○下山章夫, 佐藤直樹, 末武愛士, 木本幸治, 長尾至成, 菅沼克昭 (大阪大学)</p> <p>3. 大面積Cu下地接合用のAg焼結材料の開発 ○望月昭宏, 森田紗織, 村上佳男 (アレントジャパン)</p> <p>4. 高温放電試験後におけるAg焼結層挙動の検討 ○森田紗織, 望月昭宏, 村上佳男 (アレントジャパン)</p> <p>5. 加圧焼結したAgナノ粒子の疲労き裂進展特性と焼結接合部の熱疲労寿命予測への応用 ○高橋弘貴, 相子祐樹, 菊谷義治, 佐藤隆彦 (芝浦工業大学)</p>	<p><b>[2B4] 環境配慮型実装技術</b> 座長：森三樹 (東京大学)</p> <p>1. 家電分野における資源循環型モノづくり ○松井卓也 (パナソニック) (依頼講演40分)</p> <p>2. 二次電池シリコン負極用バインダーの最適選択による充放電特性改善 ○下位法弘 (東北大学)</p> <p>3. 有機酸添加サブミクロン粒子ペーストによる耐熱焼結接合 ○高悦<sup>1</sup>, 酒金亨<sup>2</sup>, 菅沼克昭<sup>3</sup> (大阪大学, <sup>2</sup>住友金属)</p> <p>4. マイクロ波加熱によるアルミニウムとポリアミド樹脂の直接接合と異種材料界面の分離特性 ○安田清和 (大阪大学)</p>	<p><b>[2C4] 3次元ICパッケージ-2</b> 座長：新宮原正三 (関西大学)</p> <p>1. TSV応力伝搬の動作温度依存性が及ぼすCMOS回路特性変動への影響 ○田代浩子, 宮原昭一, 土手曉, 北田秀樹, 作山誠樹 (富士通)</p> <p>2. 三次元LSI実装によるTSV近傍の応力変化とCMOS特性への影響評価 ○土手曉, 田代浩子, 北田秀樹, 作山誠樹 (富士通)</p> <p>3. 三次元積層ICの開発に向けた統合設計環境の構築 ○上杉浩<sup>1</sup>, 長谷川清久<sup>2</sup>, 福岡輝<sup>3</sup>, 泰武廣<sup>4</sup>, 村上嘉浩<sup>5</sup>, 亀岡純<sup>6</sup> (デンソー, <sup>2</sup>研研, <sup>3</sup>研研)</p>	<p><b>[2D4] 検査・センシング技術-3</b> 座長：河野好映 (オムロン)</p> <p>1. 色情報を用いた自動追従システムの開発 ○岡田英夫 (富士通研究所)</p> <p>2. Manifold表現を利用した画像位置決めにおける誤照合低減手法の提案 ○奥川尚太, 橋本学 (中京大学)</p> <p>3. 3次元共起度画像によるエッジ特徴抽出の一検討 ○松原琢磨, 武藤功樹, 興水大和 (中京大学)</p> <p>4. マイクロ波を用いた無線電力伝送システムの開発 ○谷博之<sup>1</sup>, 梶原正一<sup>1</sup>, 田中勇気<sup>2</sup>, 柳場亮祐<sup>3</sup>, 佐藤浩<sup>4</sup>, 小柳芳雄<sup>5</sup>, 藤原真毅<sup>6</sup> (パナソニック, <sup>2</sup>京都大学)</p>	<p><b>[2E4] JEITA・実装技術ロードマップ2017報告会-2</b> (15:10-16:50) 座長：本多進 (C-NET)</p> <p>1. IoTとAIによりスマート化される産業、生活と世界をリードする電子部品 ○豊田進 (KOA)</p> <p>2. 2017年度版プリント配線板技術ロードマップ ~機能集積基板へのアプローチ~ ○宇都宮久修 (インターコネクション・テクノロジーズ)</p> <p>3. 世界の実装現場を支える日本の実装設備 ○井上高宏 (パナソニックスマートファクトリーソリューションズ)</p>
16:50					